

2008年11月5日

2009年3月期 中間決算説明会

代表取締役社長
川村 誠

京セラ株式会社

本日のプレゼンテーション

2009年3月期 中間期 決算概要

2009年3月期 通期 業績予想

2009年3月期 中間期 連結業績概要

(単位:億円)

	2008年3月期 中間期		2009年3月期 中間期		前年同期比 増減率(%)
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	
売上高	6,366	100.0	6,587	100.0	3.5
営業利益	678	10.7	622	9.4	-8.2
税引前中間純利益	815	12.8	740	11.2	-9.2
中間純利益	506	8.0	452	6.9	-10.6
希薄化後1株当たり 中間純利益(円)	267.06	-	238.52	-	-10.7
設備投資額	326	5.1	370	5.6	13.5
減価償却費	373	5.9	404	6.1	8.4
研究開発費	311	4.9	354	5.4	13.9
平均為替レートの	対ドル: 119円	対ユーロ: 162円	対ドル: 106円	対ユーロ: 163円	
為替変動による 影響額 (前年同期比)	売上高	226億円	-342億円		
	税引前 中間純利益	89億円	-57億円		

2009年3月期 中間期決算要約

売上高

前年同期比 +3.5% (+222億円)

- ・ 三洋電機(株)からの事業承継による通信機器関連事業の増収
- ・ ソーラーエネルギー事業の生産量拡大によるファインセラミック応用品関連事業の増収

税引前中間純利益

前年同期比 -9.2% (-75億円)

- ・ 円高の影響 -57億円
- ・ 電子デバイス関連事業: 需要減及び価格競争の激化 (前年同期比-71.2%)
- ・ 情報機器関連事業: 米国向け需要減 (前年同期比-36.5%)
- ・ 一時的な損益の計上
 - ① 有機EL事業の固定資産の減損処理
(電子デバイス関連事業:-23億円)
 - ② 不動産売却益 (その他の事業:+106億円)

2009年3月期 連結業績予想

(単位:億円)

	2008年3月期 実績		2009年3月期				前期比 増減率(%)	
	金額	売上高比(%)	前回予想 (2008年4月)		今回予想 (2008年10月)			
			金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)		
売上高	12,904	100.0	14,760	100.0	12,400	100.0	-3.9	
営業利益	1,524	11.8	1,450	9.8	740	6.0	-51.4	
税引前当期純利益	1,748	13.5	1,650	11.2	940	7.6	-46.2	
当期純利益	1,072	8.3	1,020	6.9	560	4.5	-47.8	
希薄化後1株当たり 当期純利益(円)	565.80	-	537.91	-	295.19	-	-47.8	
設備投資額	851	6.6	840	5.7	780	6.3	-8.3	
減価償却費	756	5.9	900	6.1	870	7.0	15.0	
研究開発費	616	4.8	720	4.9	740	6.0	20.1	
平均為替レート	対ドル:114円	対ユーロ:162円	対ドル:100円	対ユーロ:155円			下期予想	通期予想
為替変動による 影響額 (前期比)	売上高	59億円	-950億円		平均為替 レート	対ドル	95円	101円
	税引前 当期純利益	75億円	-200億円			対ユーロ	120円	141円
					為替変動に よる影響額 (前期比)	売上高	-716億円	-1,058億円
						税引前 当期純利益	-273億円	-330億円

2009年3月期 業績予想修正の要因

1. 世界景気の後退

- ・ 欧米でのクリスマス商戦の低迷により、高付加価値機器の需要は伸び悩む
- ・ ドキュメント機器の需要低迷

2. 前提為替レートの変更

- ・ 通期の対ユーロ為替レートを155円から141円に変更（下期1ユーロ=¥120）

3. 通信機器の売上減

- ・ 国内携帯電話端末市場の需要鈍化
- ・ 海外携帯電話端末事業の競争激化による販売低迷

4. 電子デバイスの事業環境の悪化

- ・ 下期の需要回復は見込めず
- ・ 期初予想を上回る価格下落の進行
（セラミックコンデンサは前期末比で20%以上の価格下落を想定）

2009年3月期 下期の経営課題

**1. 好調事業を中心とした受注の確保：
ソーラーエネルギー事業**

2. 徹底したコスト低減及び企業体質強化の推進

- 設備投資計画の見直し
- 購買コストの低減
- 製造プロセスの見直しによる生産性の向上

3. 事業基盤の強化

- 中期的視点に立脚した通信機器関連事業の再構築
- 新製品、新技術開発の強化

2009年3月期 セグメント別売上高・事業利益予想

(単位:百万円)

事業セグメント	売上高		事業利益	
	金額	構成比 (%)	金額	利益率 (%)
ファインセラミック部品関連事業	70,000	5.7	3,800	5.4
半導体部品関連事業	144,000	11.6	16,000	11.1
ファインセラミック応用品関連事業	174,000	14.0	34,200	19.7
電子デバイス関連事業	250,000	20.2	9,000	3.6
部品事業計	638,000	51.5	63,000	9.9
通信機器関連事業	250,000	20.1	-17,300	—
情報機器関連事業	239,000	19.3	19,000	7.9
機器事業計	489,000	39.4	1,700	0.3
その他の事業	138,000	11.1	15,500	11.2
合計	1,240,000	—	80,200	6.5

(※連結調整及び消去 -25,000)

通信機器関連事業の課題

市場見通し

国内携帯電話

- ・市場飽和による需要頭打ち
- ・買い替えサイクルの長期化

北米携帯電話

- ・市場はスマートフォン（Qwertyキー）、WCDMAが牽引
- ・大手キャリアでの韓国メーカーのシェア拡大

通信システム

- ・FY10/3より国内にて新たな高速無線通信サービスの開始

携帯電話端末の開発及び拡販策の強化

⇒ 端末事業の収益性改善

次世代基地局等の開発促進

⇒ 安定した収益の獲得

開発体制の
統合

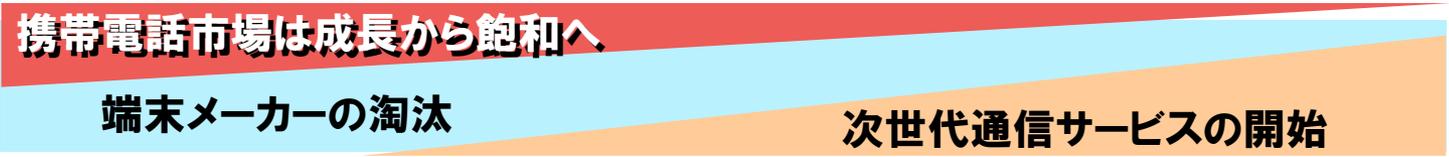
販売体制の
強化

通信キャリアとの
連携

通信機器関連事業のロードマップ

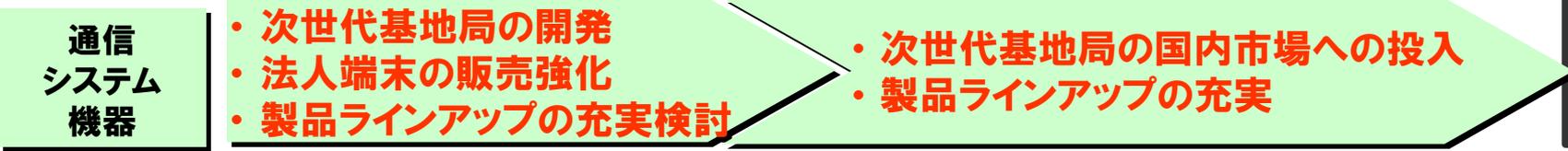


市場見通し



FY 12/3
事業利益率5%を目指す

携帯電話端末	共通	部材の共同購買開始	組織の再編成 ロードマップの統一	新顧客・市場開拓
	国内	<ul style="list-style-type: none"> 戦略商品の積極提案検討 法人向けの拡販 カードビジネスの拡大 	<ul style="list-style-type: none"> 統合ロードマップに沿った製品の投入 	<ul style="list-style-type: none"> 次世代端末の投入
	海外	<ul style="list-style-type: none"> 開発、営業体制、生産拠点の見直し検討 	<ul style="list-style-type: none"> 開発、営業体制、生産体制の見直し実施 	<ul style="list-style-type: none"> 新市場、新キャリアへの参入



電子デバイス関連事業の課題

コンデンサ事業の収益改善

課題

- 受注確保
- 価格競争力の強化
- 利益率の高い差別化製品の拡充



事業環境

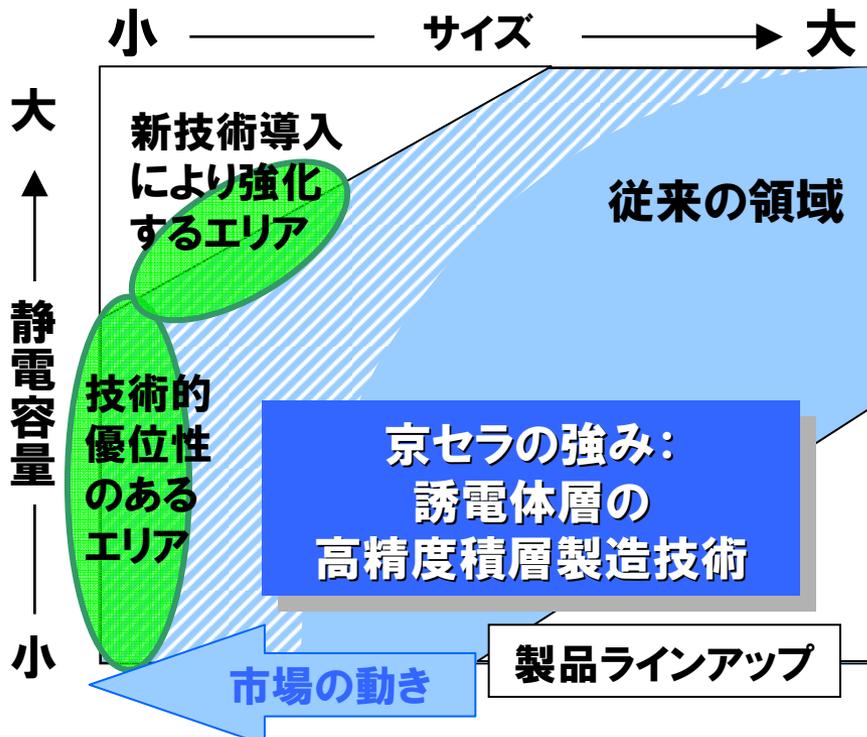
- 高級モデルの需要減による一台当たりの部品搭載点数減
- 急速な価格下落

コンデンサ事業の今後の戦略

得意分野への集中と利益率の高い製品展開で安定した収益性を確保

拡大市場で得意分野へ集中：
小型製品に特化

利益率の高い差別化製品の拡充：
材料技術や端子形成技術を駆使した製品展開



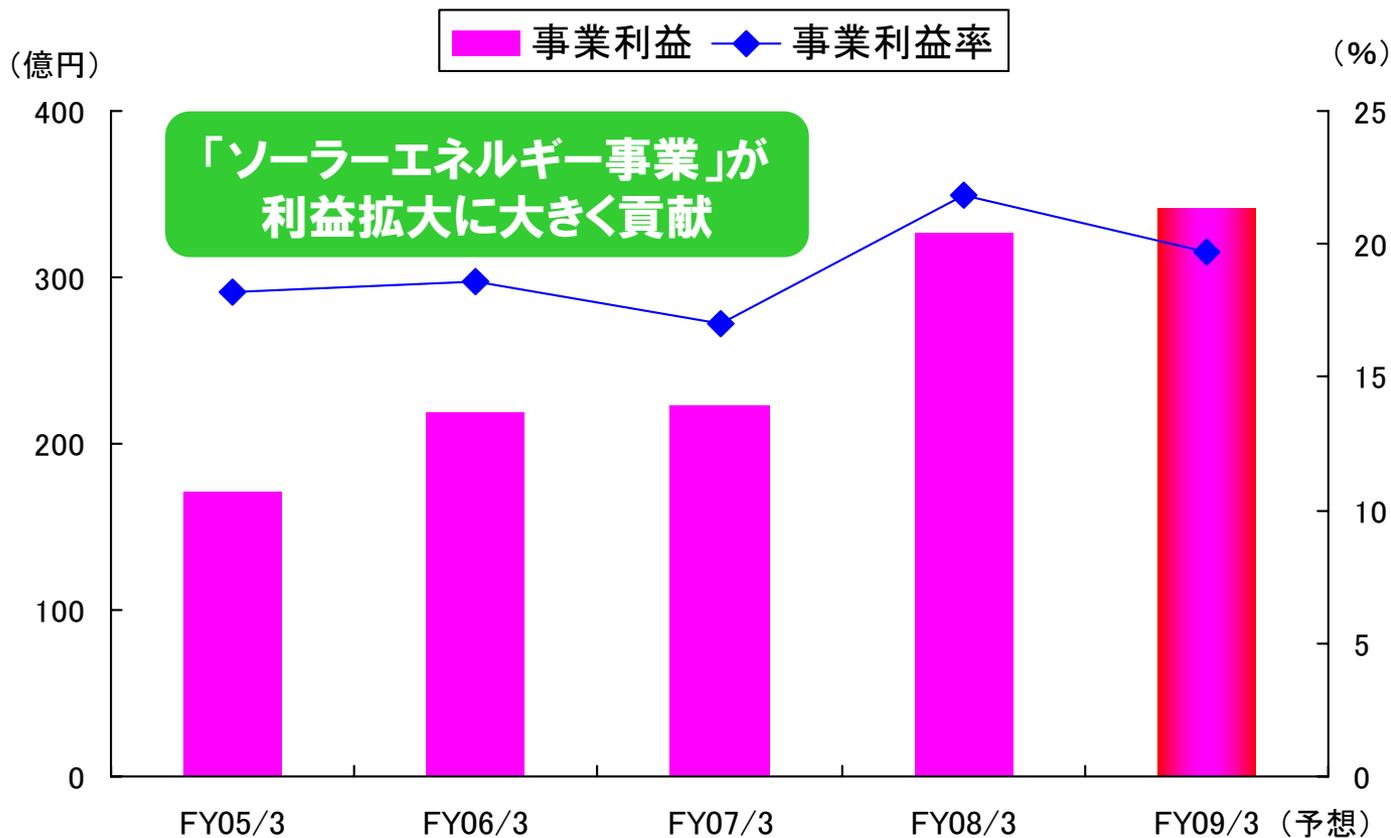
誘電体材料技術を活かした製品展開

- ・オンボード電源用
高耐電圧＋小型高容量
- ・新誘電体による
温度特性が良い製品

独自の端子形成技術を活かした製品展開

- ・小型低インダクタンス品
- ・超薄型

ファインセラミック応用品関連事業の事業利益の推移

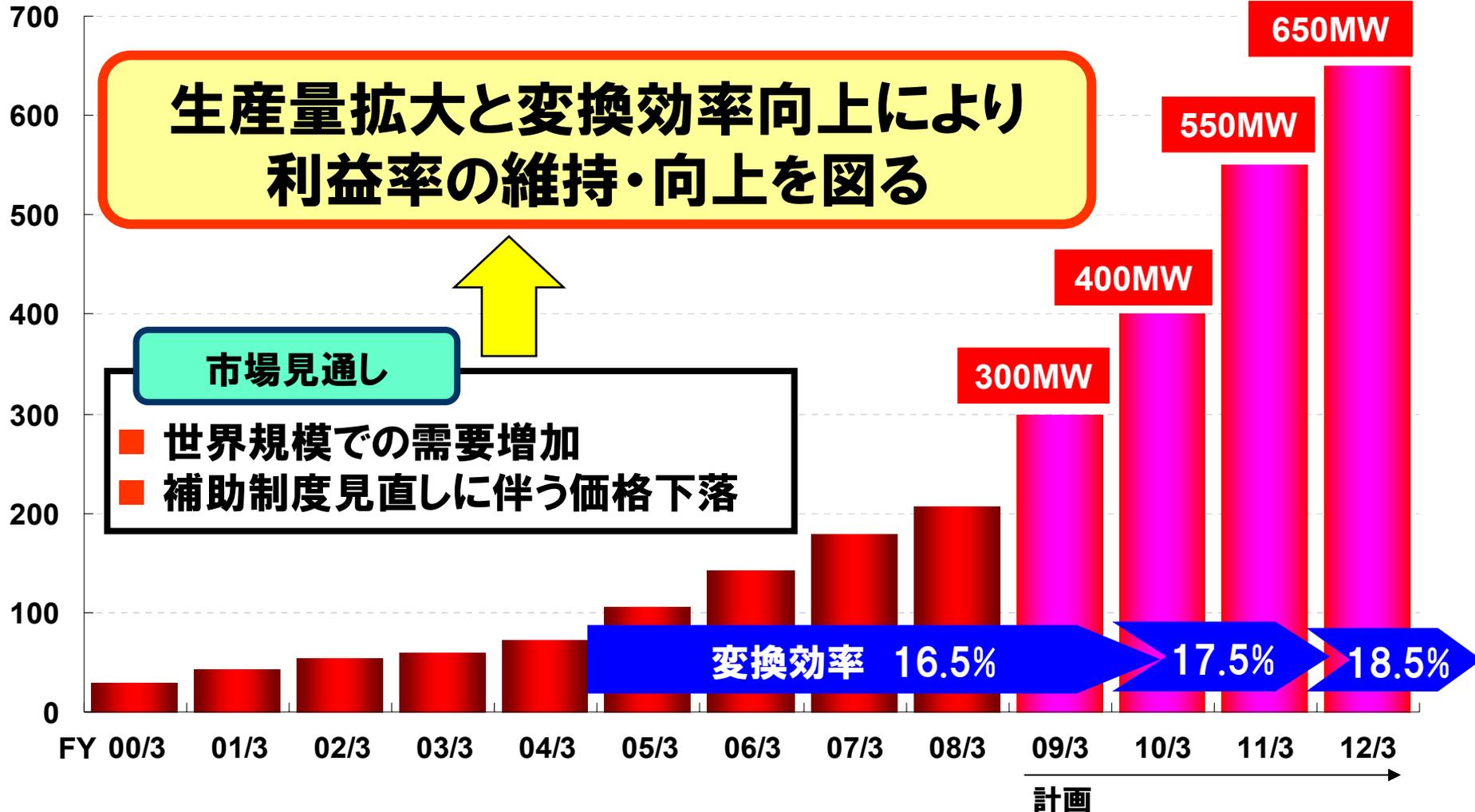


成長ドライバーとして、「ソーラーエネルギー事業」のさらなる拡大を図る

ソーラーエネルギー事業の今後の展開

太陽電池の生産計画

生産量(MW)



京セラグループの取組み

2009年3月期の重点課題

- 好調事業を中心とした受注の確保
- 徹底したコスト低減の推進
- 企業体質の強化

中期的な重点課題

- 事業基盤の強化
 - ・ 通信機器関連事業における経営資源の最適配分
 - ・ 製造、開発、販売面でのシナジー追求による新技術、新製品、新市場の創造

重点市場

通信

情報

環境・
エネルギー

車載

将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1)当社が関連する市場における経済状況(主に、日本、北米、欧州並びにアジア(特に中国))。(2)中国における経済・政治・法律面での条件の予測し得ない変化。(3)競争の激しいセラミック、半導体部品及び電子部品市場において当社が、革新的な製品を開発・生産し、品質・納期を含めて、顧客の要求に沿った先進技術を投入する能力の不確実性。(4)生産高や業績に影響を与える社外委託工程や自社内製造過程で生じる遅れや不具合の発生。(5)円高、政治・経済情勢、売掛金回収リスク、製品の価格競争力の低下、輸送経費の増大、海外事業への人材配置・管理の問題、知的財産権の保護の不十分性など、輸出に影響する可能性がある要素。(6)売上高の相当な部分を構成している通貨(特に米ドル及びユーロ)の対円為替相場の変動。(7)エンジニアリング・技術部門での熟練労働者の確保の不確実性。(8)機密保持及び特許権の保護の確保が不十分である事態。(9)製品を製造・販売する為に必要となるライセンスの継続的確保の不確実性。(10)今後の取り組み及び現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態。(11)買収した会社や取得した資産に関連して想定以上の統合費用がかかり、期待される収益又は事業機会が得られない事態。(12)テロ行為、疾病の発生など、当社の市場やサプライチェーンに悪影響を与える要素。(13)製造施設その他主要な事業関連施設が存在する地域における地震などの自然災害の発生。(14)国内外の環境規制強化に伴う当社の賠償責任や遵守義務の増大。(15)保有する有価証券及びその他の資産の時価の変動、減損処理の発生。(16)会計基準の変更。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財務状況は、これらの将来予想に関する記述に明示又は包含される将来の業績、事業活動、展開又は財務状況と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。